



2020 全球半导体产业(重庆)博览会 参展报名表(合同)

2020年10月14日-16日 重庆国际博览中心

参展单位	中文名称:				
	英文名称:				
地址:				邮编:	
联系人:		手机:		邮箱:	
电话:		职务:		传真:	

	展位类型	单价	面积	规格	展位号
展览展示	精装标展	¥12800 元/9 m ²	9 m ²	精装标展	
	光地 (36 m ²)	¥1200 元/m ²			
广告宣传					
会议论坛					
费用总额	小写:	大写:			

1. 请详细填写《参展报名表》并签字盖章后递交组委会,并于10个工作日内将费用汇入组委会指定账户。收到全款后,组委会将为参展单位开具税务局认可的等额发票。
2. 展会由深圳市电子商会负责款项收取、发票、现场服务等事项。组委会指定帐号为:
收款单位: 深圳市电子商会
收款帐号: 11003436761604
开户银行: 平安银行深圳华富支行
3. 由不可抗拒因素致使展会不能如期举办(如战争、地震等自然灾害),主办单位有权更改展期,并不承担由此产生的任何法律经济责任。
4. 在组委会确认其参展资格后,若参展商单方面取消参展计划,其已付参展费用不予退还。
5. 本展会为专业展,概不接受与展示范围不符合的企业报名。参展商不得展出侵权假冒商品,不得转让转租展位,不得展出与展会无关商品。

参展单位确认以上内容

授权代表签字盖章:

日期: ____年 ____月 ____日
(印章)

此表填好后请传至:

深圳市电子商会(印章)

深圳市福田区深南中路3006号佳和强大厦A座30楼
联系人: 刘德才

电话: 13751024091 传真:

E-mail: liu_decai@163.com